

愛普科技股份有限公司

2026.08.06 法人說明會

大家午安，我是愛普科技財務長林郁昕，歡迎各位投資先進參與愛普科技法人說明會，在會議的初段，我們將進行本公司 2026 年第二季的財務狀況及業務報告，簡報過後會進入問答階段，線上參與的投資朋友可於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆。免責聲明的部分再麻煩各位留意。

第 3 及第 4 頁是愛普科技的簡要資料，提供各位參考。

本次法說會會先由我來說明 2026 年第二季財務數字重點，洪志勳總經理將報告營運狀況以及未來展望，之後進行 Q&A，今日的與會團隊除了洪志勳總經理及我之外，還有陳文良執行長、薛澤源業務中心資深副總以及劉宗寧產品中心副總也會在線上回覆提問。

財務狀況及業務報告

林郁昕 財務長

首先由我這邊進行財務狀況報告。

首先說明 2026 年第二季的合併損益情形，愛普 '26 年第二季單季合併營收創下歷史新高，為新台幣 23.6 億元，較上季增加 13%；較去年同期則增加 78%；還原為美元銷售來看，美元營收季增 13%、年增 74%；營收增加一方面來自於 IoT^{TRAM}™的強勁需求，另外 S-SiCapTM進入量產後銷售持續成長，雙重影響推升了營收增長。

第二季毛利金額為 11.6 億元，隨著增長的營收、穩定的毛利率，毛利金額 QoQ 及 YoY 分別增加 20%及 107%；本季毛利率為 49%，QoQ 增加 3 個百分點，QoQ 毛利率 3 個百分點的增加主要是來自於有利的銷售客戶組合影響，本季單位成本雖有增加，產品單位售價亦有部分調漲帶來了有利的價差，對應抵銷了對毛利率的影響；毛利率 YoY 增加 7 個百分點，主要是來自於銷售客戶的正向組合差異。稍後總經理會再做細部的說明。

本季營業費用為 4.3 億元，較上季增加約 5,200 萬元，QoQ 增加 14%；較 '25 年同期

增加 1.4 億元，YoY 增加 49%；營業費用的增加主要來自於研發費用的變動，研發費用季增 4,600 萬元，QoQ 增加 17%，年增 1.1 億元，YoY 增加 52%，銷、管、研費用因獎金估列隨著獲利狀況調整、人數增長以及員工認股權酬勞成本增加而上升，研發費用的金額更進一步隨著研發各項新產品專案的開展而大幅增加。本季營業費用率為 18%，與上季相當，與去年同期相比則因營收增加而年減 4 個百分點。隨著公司營收持續成長，營業費用率將持續下降。

營業利益為 7.3 億元，QoQ 及 YoY 分別增加 23%及 169%；本季營業利益率為 31%，QoQ 因毛利率上升而增加 3 個百分點，YoY 增加 11 個百分點，主要是毛利率提升及營業費用率下降的影響。

業外收支部分，第二季業外淨收入為 1.1 億元，主要來自於兌換損失 2,400 萬元、利息收入 9,600 萬元及金融資產評價利益 3,100 萬元，金融資產評價利益主要來自於轉投資估值增值的影響。

兌換損失來自於美元兌新台幣匯率第二季底較第一季底貶值 0.45%的影響，本公司美元資金部位約 2 億元，主要來自於未支用的 GDR 資金。本公司已經在五月下旬取得中央銀行核准，將 GDR 資金運用計畫從購置機台設備等資本支出全數轉為充實營運資金，以支應公司在 3DIC 生態和 S-SiCap™ 新產品陸續量產帶動的營運擴張與業務成長下的資金需求。本公司已於第二季支用約 18%，預計可於 2027 年第一季度動撥完畢。排除 GDR 相關兌換損益及所得稅影響數的擬制設算資料會在下一頁做說明。

第二季稅前淨利為 8.4 億元，所得稅費用 1.7 億元，有效稅率 20%，稅後淨利金額為 6.7 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 6.8 億元，與第一季相當，YoY 部分，除本業獲利大幅增長外，'25 年同期因鉅額兌換損失而為稅後淨損，因此本季在本業獲利上升及業外淨利益下，YoY 增加 12.3 億元，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 29%，單季每股盈餘為 4.18 元。

如果排除 GDR 未支用資金所產生的兌換損益，2026 年第二季業外淨利益為 1.3 億元。而將 GDR 相關匯率影響排除後，第二季淨利金額將為 6.8 億元，其中歸屬於本公司業主的稅後淨利為 7 億元，歸屬於本公司業主的稅後淨利率為 30%。擬制調整後每股盈餘為 4.29

元。

合併資產負債表的部分，季底總資產為 169 億元，較第一季底增加 13 億元。其中，現金及約當現金為 97 億元、按攤銷後成本衡量的金融資產為 26 億元，總計金額約 123 億元，合計占總資產的 73%。按攤銷後成本衡量的金融資產是本公司承作三個月以上的定期存款。現金及按攤銷後成本衡量之金融資產這兩個科目合計數，QoQ 淨增加數約 6.6 億元，主要來自於營業活動應收應付款項的收付、定存利息帶來的淨現金流入、合約負債預收貨款及其他現金流入流出互抵後的淨影響數。

本季底應收帳款 7.9 億元，較第一季底增加 4,900 萬元，而收款天期維持在 1-2 個月，整體應收帳款回收狀況良好。存貨金額為 15.8 億元，較第一季底增加 3.9 億元，增加 32%，目前庫存大約維持 4-5 個月，我們會持續依據接單的狀況來進行動態管理。

本季底按公允價值衡量的金融資產 2.8 億元，較第一季底增加約 3,000 萬元，主要是本季對轉投資的估值增值影響。

本季底的總負債為 41.3 億元，負債比率為 24%，較第一季底增加 5.7 億元，主要是合約負債，也就是客戶預付款的增加。

股東權益總金額為 127.5 億元，扣除非控制權益 1.8 億元，歸屬於本公司業主的權益金額為 125.7 億元，較第一季底增加 7.6 億元，每股淨值為 77.04 元。

這邊再進一步說明，在第二季財報附註中也會有提到，為確保未來晶圓、封裝及測試產能的穩定供應，愛普分別與主要晶圓廠及封測廠簽訂了長期產能合作協議，預計在明年中支付晶圓廠保證金新台幣 5.34 億元、並於八月份預付封測廠 2,200 萬美元的加工款，以積極因應我們明後年業務快速成長下的產能需求。

此外，公司預計明年營收成長所需的營運資金將會超過現有的資金水位，我這裡所指的現有資金包含已經變更為營運資金的原 2022 年 GDR 資金部位。因此，為了確保公司有能擴大經營規模滿足客戶需求，7 月 24 日的臨時董事會通過提案辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案，也就是 GDR 增資案，暫定發行股數以不超過壹仟伍佰萬股為限，股權稀釋度不超過 8.43%，預期發行價格不低於參考市價的九折，這個議案我們預計在 115 年 9 月 11 日召開的股東臨時會通過。

以上是就財務資訊的相關說明，接下來時間由洪志勳總經理說明營運狀況，謝謝！

洪志勳 總經理

好的，謝謝財務長；各位投資先進大家好，接下來由我為大家報告第二季的營運狀況。

本季營運狀況將延續之前的報告架構，分 IoTRAM™、S-SiCap™以及 VHM™ 三個產品線向各位報告業績狀況。

2026 年第二季合併營收為 23.6 億元，達到歷史新高，較第一季增加了 13%，與 '25 年第二季相比則增加 78%，主要是來自於 IoTRAM™以及 S-SiCap™的營收增長。

本季 IoTRAM™營收 16.9 億元，季增 15%，維持穩定的出貨水準；YoY 則是大增 55%；本季 IoTRAM™營收占比約 71%。

VHM™產品線本季營收為 3,700 萬元，主要是 NRE 的收入，營收較第一季減少 1,700 萬元，YoY 則減少 2,900 萬元，本季占比為 2%。

S-SiCap™產品線本季營收為 6.4 億元，QoQ 增加 12%，YoY 則大增 273%，主要是來自 S-SiCap™ Interposer 多個專案進入量產的挹注。S-SiCap™產品線本季營收占比達 27%。

本季毛利率為 49%，較第一季增加了 3 個百分點，主要是來自於客戶組合的有利變化。

接下來說明盈利狀況。這一頁的左邊淺綠色是營業淨利，第二季的營業淨利為 7.3 億元，最近幾季營業淨利隨著營收增長而呈現逐季增加的趨勢。本季營業淨利率為 31%，QoQ 因毛利率上升而增加 3 個百分點，YoY 則因營收及毛利率雙雙增加和營業費用率下降的影響，增加了 11 個百分點。

右手邊的圖是業外淨收支，主要是由兌換損益、利息收入以及金融資產評價損益所組成，本季因為兌換損益而有較大幅度的波動變化。

本季營收呈現雙位數的成長，毛利率也提高，整體營業淨利較第一季有 20%以上的成長，但因業外淨收支減少的因素，本季歸屬於本公司業主之淨利為 6.8 億元，較前一季略高 500 萬元，較 2025 年第二季大幅增加約 12.3 億元，主要是因為去年第二季受匯損影響而呈現虧損的狀況。

接下來我就三個產品線在今年第二季營運狀況分別為各位先進說明。

首先我們來看 IoTRAM™產品線。

IoTRAM™延續強勁的成長動能，本季營收 16.9 億元，較前季增加 15%，YoY 增加 55%。

IoTRAM™主要有三個應用的領域，分別是 Connectivity、Wearable 以及其他。

首先是 Connectivity，在本季 IoTRAM™營收占比約 36%，QoQ 略減 3%，YoY 則是增加了 17%。

其次是穿戴式裝置，本季營收占 IoTRAM™26%，金額較前季增加了 11%，YoY 則成長了 37%。

其他應用的部分在本季營收大幅成長，主要是 Display 客戶的需求增加。QoQ 以及 YoY 分別增長 41%以及 153%，在本季 IoTRAM™營收占比約 38%。

接下來我針對 IoTRAM™的營運展望，為各位進一步說明。

首先，我們看到 IoTRAM™的需求動能非常強勁，除了現有的各種應用需求持續提升以外，原來許多是用標準型 DRAM 的應用也在成本以及供給的壓力下，變更設計採用了 IoTRAM™，進一步拓展了 IoTRAM™的應用市場；另外，除了出貨量的增加，由成本上升推動的價格調整也是營收增長的另外一個因素。

之前向各位先進報告的 ApSRAM™，有數個穿戴裝置目前已經進入量產，另外 MCU 國際大廠都紛紛採用 ApSRAM™，主要是用來支援 Edge AI 的應用，同時，更高容量的 ApSRAM™也在持續開發當中，隨著一系列 ApSRAM™產品進入量產，ApSRAM™的營收在這一兩年會貢獻 IoTRAM™顯著的營收占比。

我們的 IoTRAM™已經經營了十多年的時間，產品效能、品質以及穩定的供給，已經廣泛地獲得客戶的肯定，由於標準型記憶體市場波動劇烈，客戶由標準型記憶體轉換到 IoTRAM™的趨勢不會改變，IoTRAM™的成長空間仍是非常大的。同時，我們看到需求大過於產能，將會持續爭取拓展產能的機會，以支持客戶縮小供應的缺口。

接下來是 S-SiCap™產品線。

S-SiCap™產品線涵蓋我們矽電容的各種形式產品，其中包括了矽電容中介層 (Interposer with S-SiCap™)，我們叫做 IPC，以及分離式的 S-SiCap™，我們稱作 IPD。

S-SiCap™產品線延續前季的營收高水準，本季來到了6.4億元，較前季成長了11.5%，

YoY 則是成長了 2.7 倍，這主要是本季 IPC 多個專案持續放量出貨的挹注。

接下來我用這張圖來說明我們 S-SiCap™ 產品在 HPC 以及 AI 先進封裝的應用。AI/HPC 晶片功耗持續攀升，供電電壓隨著先進製程而降低，再加上封裝尺寸不斷擴大，使得先進封裝在電源/訊號完整性(PI/SI)的挑戰更加嚴峻，對矽電容的數量以及單位容值的要求也越來越高，我們的 S-SiCap™ 正是針對 AI/HPC 設計的解決方案。

標示一的部分是帶電容的矽中介層，也就是 IPC。我們的 IPC 是市場上少數符合客戶對容值要求的矽中介層，有多個專案穩定量產當中。因為力積電銅鑼廠設備遷廠的因素，IPC 第三季的營收可能會有所延遲，第四季會恢復成長。

標示二是我們 S-SiCap™ 在嵌入封裝基板(embedded in substrate)的應用，我們稱作 IPD。單一基板會需要近百顆的 IPD，需求量是很大的。前季向各位報告過，這個應用在本季會逐漸進入量產出貨，目前需求的能見度已經到了 2028 年，並且從明年第一季開始出貨爬升的速度會非常的快，對 2027 年營收將會有非常顯著的貢獻。

第三種的應用是將 IPD 貼在封裝基板的底部，也叫做 Land-Side-Cap (LSC)，這個在手機晶片封裝的應用已穩定量產當中。

S-SiCap™ 在 IPC 需求穩定升溫以及嵌入基板的 IPD 量產迅速爬升的挹注，我們預期 S-SiCap™ 產品線在 2027 年的營收有數倍的成長，營收占比將有機會超越 IoTRAM™。

接下來我們看 VHM™ 產品線。

本季營收 3,700 萬元，較前季減少，主要是 NRE 收入較前季少的原因。YoY 金額也減少了 2,900 萬元。VHM™ 產品線目前營收主要是來自 NRE 的收入，少量 wafer sales 則是工程樣片的出貨。

接下來我用這張 VHM™ 發展演進圖來說明 VHM™ 產品線發展的歷程。

VHM™ 產品線從 2018 年開始經營，由初期的產品架構驗證、到第二階段的乙太礦機應用進入量產以及多個主流客戶在 AI/HPC 應用產品的概念驗證暨執行，這階段包括了一片邏輯晶片疊一片 DRAM，也就是 1+1，和一片邏輯晶片疊多層 DRAM，我們稱作 1+N，在 2024 年第四季完成架構的驗證，現在進入了第三個階段，也就是 AI/HPC 量產產品專案的執行階段。

VHM™產品架構不論是在記憶體頻寬以及功耗的表現上，已經被主流客戶認可大幅優於市場上其他的記憶體解決方案。我們目前有數個產品專案設計進行當中。

在本季，除了有數個新的 Datacenter 以及 Edge AI 產品專案與客戶在討論中，我們第一個 1+8Hi 的 VHMStack™，也就是一片邏輯晶片加八片 DRAM 晶片堆疊，已經成功展示產品功能，目前產品驗證順利進行當中，預期量產時程會落在 2027 年底到 2028 年初。

以上是三個產品線在第二季的 Update。

最後，我就愛普未來的展望向各位先進說明。

今年開始，愛普將進入一個快速的成長期。

IoTRAM™的應用市場持續擴大、需求強勁，再加上 S-SiCap™的 IPC 與 IPD 進入量產，尤其是 IPD 在嵌入基板的應用量產，這部分的需求量非常大，並且量產爬升的速度非常快，預期明年 S-SiCap™產品線營收有機會超越 IoTRAM™。再加上 VHM™預計在 2028 年開始量產加入營收貢獻，這三個產品線同時挹注營收，我們有信心在未來幾年營收將以倍數成長。

另外，整體營運規模隨著營收的倍數成長，愛普將會進入另一個層級的挑戰。由於我們經營的是客製化產品，在供貨保證以及供應鏈的產能確保，是目前重點的工作。剛才財務長也有報告過，我們和晶圓廠以及封測廠已經簽訂了產能保障協議，另外我們也持續與其他供應鏈夥伴討論以確保產能供應無虞。除了產能保障協議的存出保證金，因應出貨數量倍數成長，庫存也會隨之增加，對營運資金的需求將會提升數倍，我們在 2022 年募集的 GDR 已變更用途作為營運資金，但這部分仍然不足以支持未來幾年營運成長的需求，我們計畫再發行 GDR 以募資，充實營運資金。我們選擇 GDR 主要是希望透過 GDR 來擴大全球投資人覆蓋範圍並開拓國際資金來源。我們 7 月 24 日臨時董事會已經通過發行不高於壹仟伍佰萬股普通股參與 GDR 募資，預計股權稀釋率不高於 8.43%。

以上是我的報告，謝謝。

Q&A

謝謝總經理。本次的簡報到這裡告一個段落，接下來進入問答階段，請各位投資朋友於畫面右下角欄位輸入您的問題，我們將於整理後統一回覆，謝謝。

問題：請問怎麼看 2H26 需求以及 2027，IoTRAM™及 S-SiCap™營收持續強勁成長的動能是？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

這題我從 IoTRAM™跟 S-SiCap™兩個產品線分別作說明。

IoTRAM™從今年下半年會維持滿產能量產，晶圓和後段測試還是有產能限制，其中後段測試產能會隨著新購測試針卡上線而有所提升，但是總體產能的提高還是有限的，營收持續的成長主要來自於反映上升成本的價格調整，而 2027 年的主要成長動能將來自於市場對於 ApSRAM™等新產品的需求。

S-SiCap™的 IPD 在今年下半年是處於起量階段，2027 年就會放量數倍。S-SiCap™的 IPC 的市場需求，在 2027 年也會有顯著的成長。

問題：整體毛利率可否持續提升？怎麼看個別產品線 IoTRAM™或 S-SiCap™的毛利率？

回答：洪志勳 總經理

長期來看，我們整體毛利率會落在大概是 45%左右，穩中有升。IoTRAM™的毛利率會在 45%上下。S-SiCap™由於現在量產還在初期，毛利率在這個平均值的附近，我們預計進入大量生產之後毛利率會再持續增加，會再略高於這樣的一個水準。

問題：IoTRAM™是否有受到 Foundry and OSAT 供應商的漲價？如果有，幅度為何？相對，公司可否漲價？如果有，漲價幅度為何？

回答：洪志勳 總經理

的確，今年 Foundry 及 OSAT 的代工價格都有調整，而且漲幅是蠻明顯的。因應成本

的增加，我們在報價的部分也做了適度的調漲，主要是與客戶共同分擔整體成本上升的壓力。

問題：IPD 及 Interposer 目前的月產能是？可否分享到 2Q27 底 以及 4Q27 底的產能規劃？

供應商是否會順利配合？兩者產能可以共用嗎？

回答：洪志勳 總經理

我先回答最後一個問題，IPC 與 IPD 有部分產能是可以共用的，這兩個產品的製程，在電容段是相同的，可以共用。後段製程則不同，所以不能共用。

除了第三季出貨我們受到力積電銅鑼廠設備遷廠的影響之外，IPD 與 IPC 合計在今年產能會逐月增加，明年起我們和 Foundry 及 OSAT 都有簽訂了產能保障協議，主要原料和加工服務的供給都有一定的保障。

問題：公司之前有提過，IPD S-SiCap™ 6 月會進入試產，請問目前試產的進度是否滿意？

相較於客戶時程，為何要這麼早試產/量產？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

IPD 的試產與量產時程還是依照客戶訂單以及產品導入的需求來作規劃，愛普持續與供應鏈夥伴保持密切合作，確保生產資源與供貨時程能夠配合客戶量產計畫及市場需求。目前進展順利。

問題：市場傳出有同業也跨入 IPD，會不會擔心 IPD 供過於求，進而壓縮到愛普在 IPD 的發展機會？

回答：劉宗寧 產品中心副總

我們當然會關心市場的變化。其實 IPD 的市場才剛開始發展，未來規模潛力很大，有新的競爭者是非常正常的。IPD 的開發過程需要和多個供應鏈夥伴一起合作及驗證，愛普已經耕耘了非常多年，具有領先的優勢。所以目前我們認為愛普的機會並沒有被壓縮到。

問題：IVR 的進度？預計何時量產？

回答：陳文良 執行長

我首先澄清一下，目前愛普在 IVR 方面的服務模式是跟業界的夥伴合作，愛普提供高密度的電容和先進封裝相關的關鍵技術服務，目前愛普沒有計劃直接生產或銷售 IVR。

目前我們的電容和技術服務都有被採用。但是 IVR 這個市場還需要一點時間，量產的時間還不太確定。

問題：2H26 Opex guidance？

回答：林郁昕 財務長

隨著營運規模的成長，營業費用的金額會隨著人力擴編、獎酬提列、研發專案的推進而持續地增加，但營業費用增加的速度不及於營收成長的速度，所以我們預計下半年的費用率應該會減少，低於第二季的 18%。

問題：請問分散 Foundry supplier 的進度？有預計第二供應商長期能佔到愛普多少的供應產能嗎？

回答：洪志勳 總經理

我們目前的確是有幾個由客戶驅動的專案在其他 fab 已經有 tape-out，由於我們才剛 tape-out，現在還是非常初期的階段，距離量產大概還需要一到兩年左右。目前沒有比較明確的一些產能訊息可以分享，但是長期來說，我們都希望這些供應商能夠成為我們長期的策略供應夥伴。

問題：公司現金充足，為何要發 GDR？可否給一個充足的理由？為何不考慮 CB / ECB / 聯貸？

回答：林郁昕 財務長

的確，公司財務結構相當穩健、帳上的現金相對於目前的業務規模是充裕的，但是，如剛才在報告中與問答中所提到的，我們公司預計明後年業務成長的幅度很大，會需要更多的

營運資金，我們也預期會超過現有的現金水位，更具體地說，隨著 IPD 的量產、IoTRAM™ 的持續成長，以及 VHM™ 的逐漸貢獻，我們預期明後年的營收會有爆發性的倍數成長，我們必須要確保有足夠的營運資金，才能滿足對於客戶的出貨承諾，來支撐營收的成長。我們再次來發行 GDR 就是要補足營收快速增長下所產生的營運資金缺口。

至於 CB/ECB/聯貸，這些本質上還是債務工具，都會提高公司的財務槓桿，我們愛普的 fabless 商業模式在本質上就是高槓桿的，所以在考量風險和長遠的成長潛力之後，我們選擇以股權增資作為籌資工具，未來公司在一個更大規模更穩定的時候，我們可能會再進一步考慮債務工具。

另外，公司選擇 GDR，而不是走臺幣現金增資，主要的目的是進一步增加公司在國際資本市場的能見度，國際資本市場的資金池也比較大。

問題：應用 VHM™ 的穿戴式產品預計何時大量產？可能營收貢獻？

回答：劉宗寧 產品中心副總

產品的量產預計在'27 年之後。因為這是新的應用市場，目前並不容易估算帶來的營收貢獻。

問題：預計 HPC 產品何時 risk production? 何時大量產？預計營收貢獻？

回答：劉宗寧 產品中心副總

應用 VHM™ 的 HPC 產品項目，目前已經在和客戶討論規格的階段，有機會在'27 年之後試產，由於 AI/HPC 的整體市場發展非常迅速而且產品的價值高，一旦大量量產就能夠有顯著的營收貢獻，但明確的數字目前的確不容易估算。

問題：VHM™ 產品線有考慮提高授權比例來加速市場的應用嗎？

回答：劉宗寧 產品中心副總

我們對於 VHM™ 的商業模式一直是保持開放的態度，只要能夠把市場的餅做大，我們不排除任何可能的合作方式。

問題：目前與美商客戶合作應用在 EMIB-T 的 IPD 案子，目前出貨進度？明後年的接單量確定了嗎？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

愛普不便說明特定客戶的需求與生產進度；如前所述，愛普的確是依據客戶長期的訂單與需求的計畫，來規劃今年下半年的起量跟 2027 年的放量生產。

問題：有提到與晶圓廠、封測廠合作簽訂 LTA，可否說明一下內容？

回答：洪志勳 總經理

這部分在我們第二季的季報裡面有比較完整的說明，剛才在報告中財務長也有簡略說明一下，但是我想我在這裡還是簡短的回答。我們與力積電和 OSAT 大廠分別已經有簽訂了長期的產能保障協議，來確保 IPD 在未來 3~4 年的產能供給。依據合約，我們會分別支付約 5.3 億元台幣以及 22M USD 給力積電以及 OSAT 作為產能保證金。我們預計大概 3-4 年之間的產能是沒有問題的。

問題：愛普很看好 IPD 的發展，怎麼看這個市場的 TAM？在競爭者越來越多之下，愛普對這個市場的把握度如何？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

在今年下半年到 2027 年高速放量生產之後，我們預期 IPD 的中長期市場需求以及相關的應用會維持成長的趨勢。這個市場背後的驅動力是 AI 加速器的功耗越來越大，需要的 IPD 會隨著功耗成正比地增加，所以市場的 TAM 很大，成長也很快，由於這樣的產品在客戶驗證流程的繁複，所需時間也很長，愛普在 IPD 市場有先行的優勢，我們也會持續開發更高容值密度的產品來符合市場與客戶的需求，維持我們的領先地位。

問題：七月營收 11 億，創紀錄，這個趨勢可以持續嗎？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

如前所述，在 IoTRAM™ 強勁需求、ApSRAM™ 等新產品量產、以及 S-SiCap™ IPC 與 IPD 業務放量成長的帶動下，我們看好 2026 年下半年以及 2027 年的營收成長動能，對未

來營運展望維持樂觀的看法。簡單地說，我們目前看到的是，營收成長趨勢可持續。

問題：力積電 P 5 出售造成對 IPC 的影響是否都已經反映完成了？

回答：洪志勳 總經理

銅鑼廠的機台搬遷主要影響會在第二季到第三季中的投片數量，對業績的影響大概會落在第三季中到第四季初。以目前來說，已經陸陸續續開始恢復生產，我們預期到第三季底的時候這個影響會都反映完成，我們在 IPC 的業績在第四季會持續成長。

問題：請問目前公司各項訂單的產能公司的掌握度如何？有無產能不足的狀況？

回答：洪志勳 總經理

客戶的訂單能見度我們是看到明年，目前確實是面臨到需求大於供給的狀況，但這也是目前市場上普遍的現象，我們目前和主要供應鏈夥伴都已經簽了產能保證協議，我們也在持續尋求更多產能，以縮小供需差距。

問題：IPD 與主流客戶的應用耕耘三年多的產品項目，前期法說提到今年第二季會進入量產，

請問目前是進行中的狀態嗎？營收貢獻開始反應了嗎？洪總說此項產品量產之後的爬升速度是相當快的，那麼可以解釋成反映在營收上的爬升速度亦可等速成長嗎？

回答：薛澤源 業務中心資深副總

如同今天前面的說明，IPD 在今年第二季已經開始出貨，也貢獻了 S-SiCap™ 產品線的產品營收，如前所述，我們配合客戶的長期訂單以及需求規劃，今年下半年就會進入快速拉升階段，2027 年會大規模放量生產，對營收會有顯著的貢獻。

問題：公司是否有評估矽電容 (IPD / IPC) 的 TAM / SAM 市場規模？中長期希望達成的市占率或市場定位為何？

回答：陳文良 執行長

IPD/IPC 的市場先前主要集中在台積電，如果在看台積電之外的市場的話，我們現在的

市占率應該是相當高的，市場的規模目前可能是一個月幾千片，但是成長是很快的。

問題：營收大幅成長，但稅後淨利率降至 28.24%。請問主要原因為何？是產品組合、毛利率、營業費用、匯率，或其他一次性因素所致？

回答：林郁昕 財務長

主要影響數來自於匯率的波動，因為美金佔愛普的現金部位比例相當大，所以美元匯率的波動很容易就會造成帳面上的損益波動。

問題：論文中有提及 Intel、SoftBank、SAI Memory、力積電 (PSMC) 及愛普共同參與 Z-Angle Memory。請問愛普在此技術中的主要角色為何？是 3D 記憶體架構、PDN / 矽電容，或其他關鍵技術？是否運用了公司的核心 IP 與專利優勢？

回答：陳文良 執行長

我想您指的是 2026 年在夏威夷的 VLSI Symposium 上，愛普有跟 Intel、SAI Memory、力積電共同發表了一篇 Z-Angle Memory 的論文，這個論文裡面愛普的貢獻是我們的 VHM™ 相關技術。

問題：愛普接任來頡董事長後，雙方目前的合作重點有哪些？來頡在愛普未來產品布局中主要負責哪些技術或產品，是否已經有具體的合作成果可以分享？

回答：陳文良 執行長

來頡的長處是 PMIC 的設計，愛普的長處跟這個相關的是電容和先進封裝的技術。所以我們跟來頡的合作目標是結合愛普的電容和先進封裝技術，以及來頡的 PMIC 設計能力，在 3DIC 特別是 HPC 的供電方面做出一些新的產品。目前有些進展，但是還沒有可以報告的具體內容。

以上是今天的問答階段，謝謝大家的參與，會後若有其他的問題，各位可聯繫本公司的 IR 團隊。謝謝！

聲明

若逐字稿內容與法說會現場陳述內容有不一致之處，應以法說會現場陳述內容為準。

上述訊息所提供對於產業及本公司前景之預測，係根據目前營運及公開資訊所做出之判斷，相關內容具風險與不確定性，任何外在環境的改變均可能影響公司實際營運與財務狀況。

上述訊息中所提供之資訊，不代表本公司對產業狀況或後續重大發展的完整論述，本公司亦不會因任何新的資訊或事件而更新相關資訊。